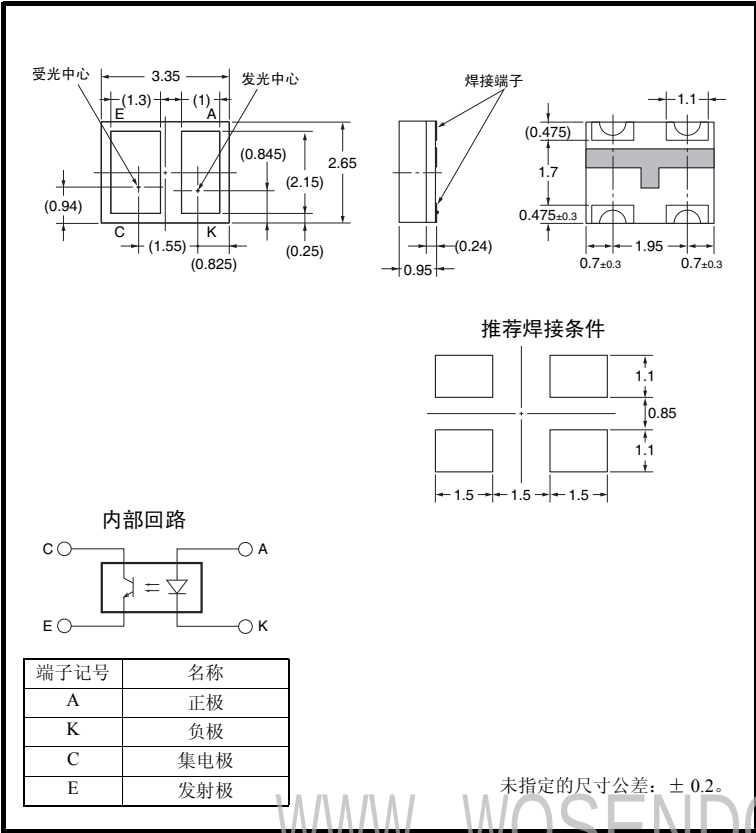


外形尺寸

(单位: mm)



特征

- 超小型传感器
- 印刷线路板表面实装型

绝对最大额定值 (Ta = 25°C)

Table with 5 columns: Item, Symbol, Rated Value, Unit. Rows include Forward Current (IF), Reverse Voltage (VR), Collector-Emitter Voltage (VCEO), and Operating Temperature (Topr).

- *1 环境温度超过 25 °C 时, 请参阅温度额定值图。
- *2 脉冲宽度 ≤ 10μs、重复 100Hz
- *3 焊接时间请控制在 10 秒以内
- *4 焊接时间请控制在 3 秒以内

电气及光学特性 (Ta = 25°C)

Table with 7 columns: Item, Symbol, Min., Typ., Max., Unit, Conditions. Rows include Forward Voltage (VF), Reverse Current (IR), Maximum Emission Wavelength (λP), Photocurrent (IL), Dark Current (ID), Leakage Current (ILEAK), and Rise/Fall Times (tr, tf).

* d 表示传感器上面至反射物的距离

■ 额定值・特性曲线

图 1. 正向电流・集电极损耗的温度额定值图

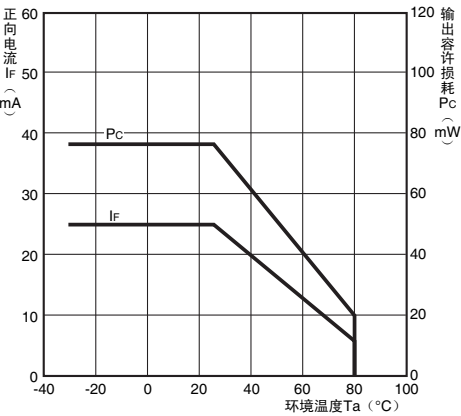


图 2. 正向电流—正向电压特性 (TYP.)

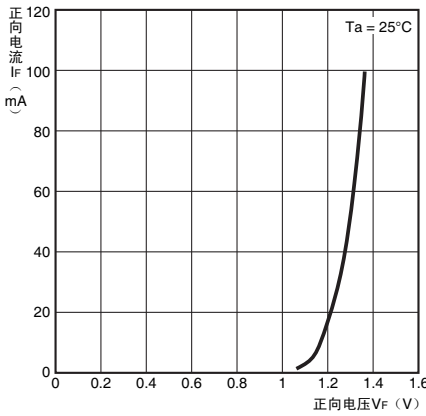


图 3. 光电流—正向电流特性 (TYP.)

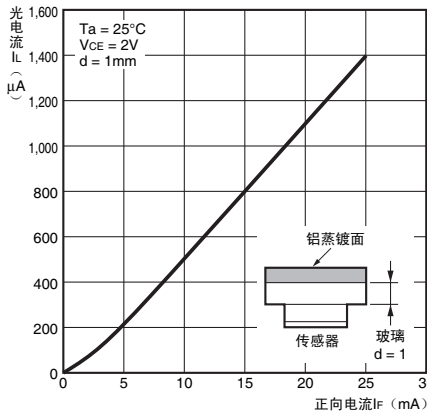


图 4. 光电流—集电极发射极之间的电压特性 (TYP.)

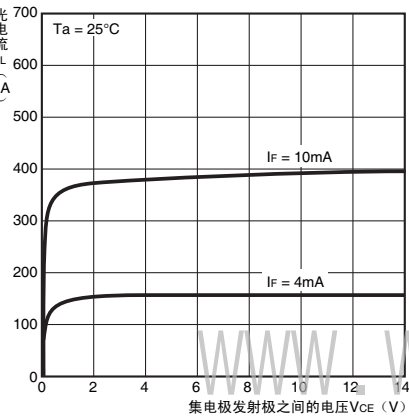


图 5. 相对光电流—环境温度特性 (TYP.)

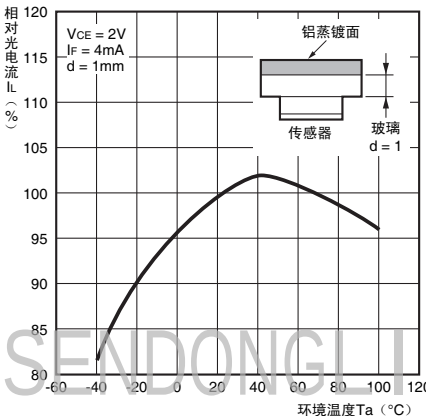


图 6. 暗电流—环境温度特性 (TYP.)

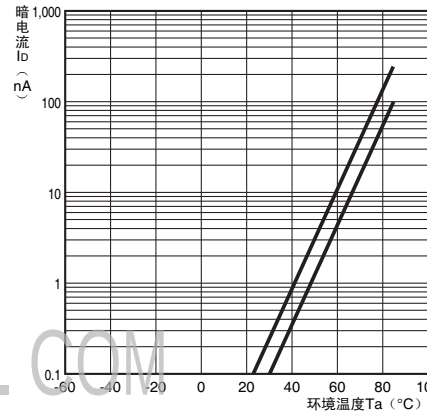


图 7. 应答时间—负载电阻特性 (TYP.)

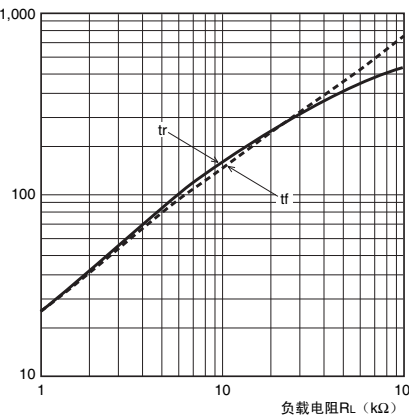


图 8. 检测位置特性 (TYP.)

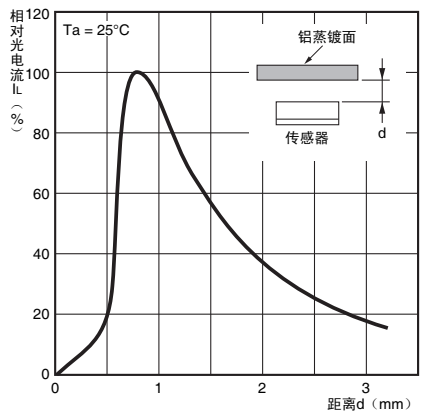


图 9. 检测位置特性 (TYP.)

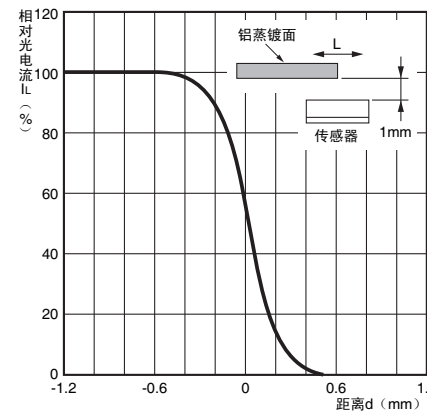
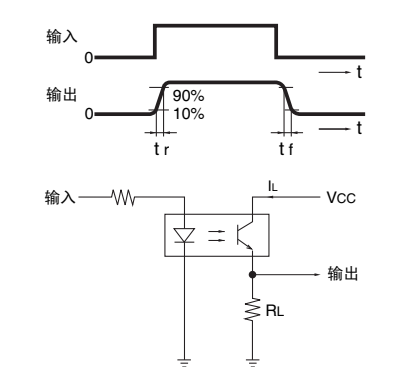


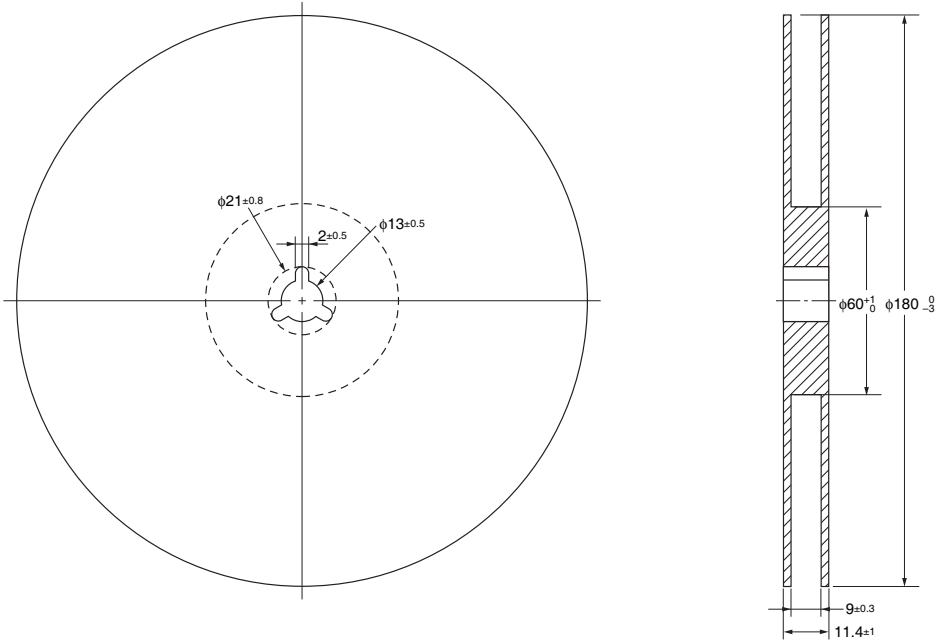
图 10. 应答时间测定回路



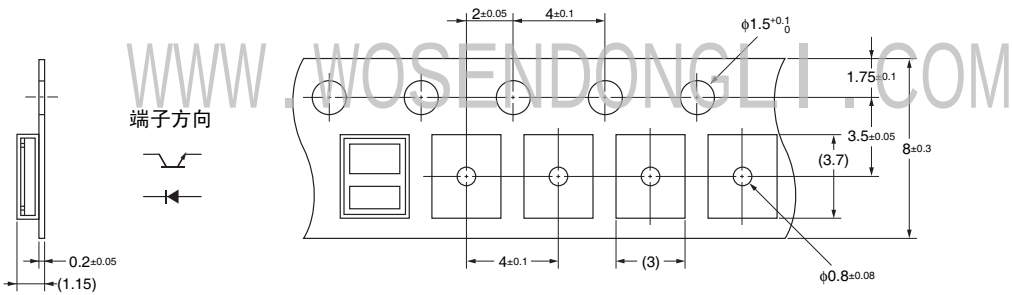
EE-SY193

■ 编带规格

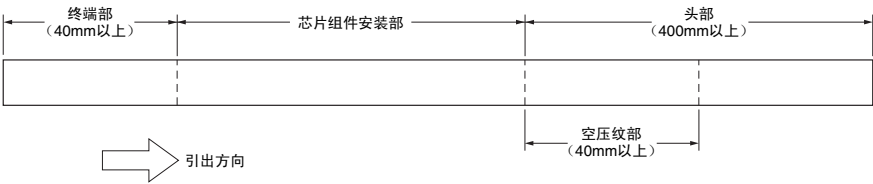
● 卷轴形状尺寸（单位：mm）



● 编带尺寸（单位：mm）



● 编带形式



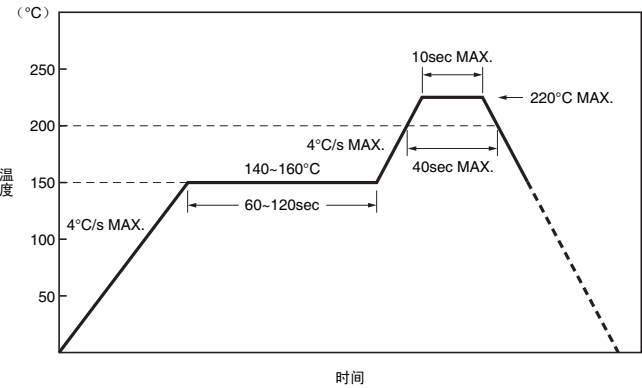
● 数量

3,000 个 / 卷

■ 实装注意事项

● 回流焊接

- (1) 建议使用以下规格的锡膏。
溶化温度：178 ~ 192 °C
成 分：Sn63%、Pb37%
- (2) 建议金属面罩厚度 $t = 0.2 \sim 0.25\text{mm}$ 。
- (3) 请设定回流炉的相关条件，使产品表面温度符合下图温度曲线。



● 手工焊接

- (1) 请使用共晶焊或银焊。
- (2) 请使用 25W 以下的烙铁，并将烙铁温度控制在 300 °C 以下。
- (3) 焊接时，每个端子的时间不可超过 3 秒。
- (4) 焊接产品需等其恢复常温后，才能进行其他处理。

■ 保存方法

为避免产品吸收湿气，开封前最好将产品保存于干燥箱内。若没有干燥箱，建议保存条件如下。

温度：10 ~ 30 °C

湿度：60%RH 以下

产品外包装具防潮功能，请在开封后 48 小时内进行回流焊接，且环境温度低于 30 °C、湿度低于 80%RH。

若开封后不得不再保存，请保存于干燥箱或再进行密封。

■ 烘烤

若防潮包装超过 6 个月，或开封超过 48 小时，请在使用前按照下述条件进行烘烤。

烘烤条件：60 °C × 24 小时以上（卷起状态）
80 °C × 4 小时以上（散开状态）